산업통상자원부 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2024. 2. 13.(화) 11:00 < 2.14.(수) 조간 > 배포 2024. 2. 13.(화)

반도체 첨단패키징 초격차 기술을 선점할 주역을 찾습니다

- 해외 선도연구기관 및 선도기업과 국제공동협력과제 198억 원 지원
-「전자부품산업기술개발(첨단전략산업초격차기술개발)」사업공고

반도체 첨단패키징 초격차 기술개발을 위해 해외 선도연구기관 및 선도기업과의 기술협력을 추진하는 국내 반도체 소재·부품·장비·후공정 기업, 학계 및 연구계를 지원하기 위한 사업이 올해부터 본격적으로 추진된다. 산업통상자원부(장관 안덕근)는 국내 반도체 첨단패키징 관련 기술경쟁력 확보를 위해 「전자부품산업기술개발(첨단전략산업초격차기술개발 반도체)」 사업을 2월 14일(수) 공고한다.

첨단패키징은 디지털 전환에 따른 고성능·다기능 반도체 수요 증가로 미세공정의 기술적 한계 극복 및 개별 소자들의 단일 패키지화 필요성 증가에 따라 핵심기술로 부상하였다. 특히 칩렛, 3D 등의 첨단패키징 기술 구현을 위한 이종접합 및 다단 적층용 신규소재 개발과 선단 공정개발은 반도체 초격차 기술확보의 화두가 되었다.

이에 산업부는 첨단패키징 기술경쟁력 확보를 위해 글로벌 선도연구기관 및 선도기업과의 연구개발(R&D) 협력체계 구축 및 공동연구 개발을 위한 신규사업을 공고하였다. 동 사업은 총사업비 394억원('24년 198억원) 규모로 국비·민간 부담금 매칭 방식으로 지원된다. 지원분야는 첨단패키징 공정·장비, 분석·검사, 소재로 지원 대상은 국내 반도체 관련 학계, 연구계, 기업이며 선정된 기관은 33개월간 정부출연금 총 55.5억원 이내의 지원을 받을 수 있다. 이번 사업은 2월14일(수)부터 3월14일(목)까지 접수할 예정으로, 사업공고의 상세내용은 범부처통합연구지원시스템(www.iris.go.kr)에서 확인가능하다.

산업부 관계자는 "첨단패키징은 시스템반도체 글로벌 공급망 확보를 위한 핵심 분야로 정부는 '반도체 첨단패키징 선도기술 개발'을 위한 대규모 연구개발(R&D)사업 추진 등을 포함하여 반도체 패키징 기술경쟁력 강화 및 견고한 생태계 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

담당 부서	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관	라정인 (044-203-4276)

新성장 4.0 상상을 현실로 대한민국 정책브리핑 OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고 **「첨단전략산업초격차기술개발(반도체)」 사업 개요**

□ 사업개요

○ **(사업목적)** 첨단 패키징 초격차 전략기술 확보를 위한 선도국과 국제공동 R&D 추진

○ **(추진근거)** 과학기술기본법 제16조 5(성장동력 발굴·육성), 산업기술혁신촉진법 제11조(산업기술개발사업), 국가첨단전략산업법 제25조(국가첨단전략기술개발사업의 추진)

○ **(지원기간)** ‘24년 4월 1일 ~ ’26년 12월 31일

○ **(예산)** 총 394억원(’24년 198억원)

○ **(추진체계)** 총괄기관(산업통상자원부), 전담기관(한국산업기술기획평가원)

□ 지원내용

○ **(지원대상)** 대학, 연구소, 기업 대상
단, 기술료 징수 대상 과제는 기업(영리기관) 참여 필수

○ **(지원비율)** 컨소시엄 구성에 따라 국비 지원비율 차등 적용

연구개발기관 유형	정부지원연구개발비 지원비율
중소·중견기업이 아닌 기업	해당 연구개발기관 연구개발비의 50% 이하
중견기업	해당 연구개발기관 연구개발비의 70% 이하
중소기업	해당 연구개발기관 연구개발비의 75% 이하
그 외	해당 연구개발기관 연구개발비의 100% 이하

○ **(지원분야)** ❶첨단 패키징 선도기술개발을 위한 전략원천기술개발, ❷차세대 패키징 기술 실용화 연구인력 및 장비인프라 교류

□ 추진일정

사업공고	신청.접수	선정평가	선정.협약	사업추진
공고/홍보	전산접수	평가위원회 개최	전문/연구개발기관	진도점검 등
’24.2.14.~ ’24.3.14. 18:00	’24.2.29.~ ’24.3.14. 18:00	’24년 4월	’24년 4월	~’24년 12월